

銅素材上への無電解銀めっき液
Electroless Ag Plating Process on Cu Substrates

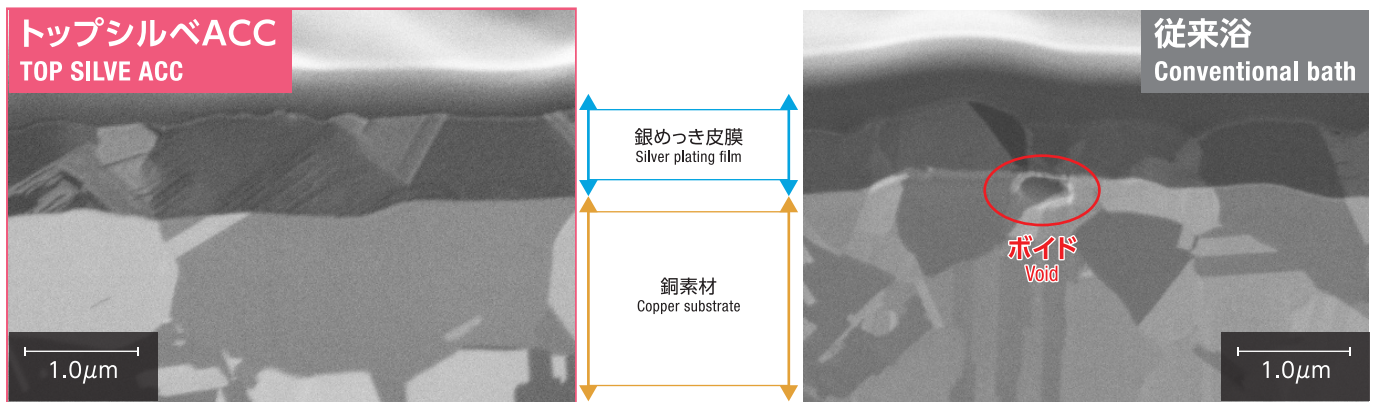
トップシルベACC

TOP SILVE ACC

- 銅素材上に無電解銀めっきが直接可能
Can conduct direct silver plating on copper
- 密着性およびファインパターン性に優れる
Great adhesion, fine pattern ability
- 下地銅の腐食が少ない
Can reduce corrosion on base copper

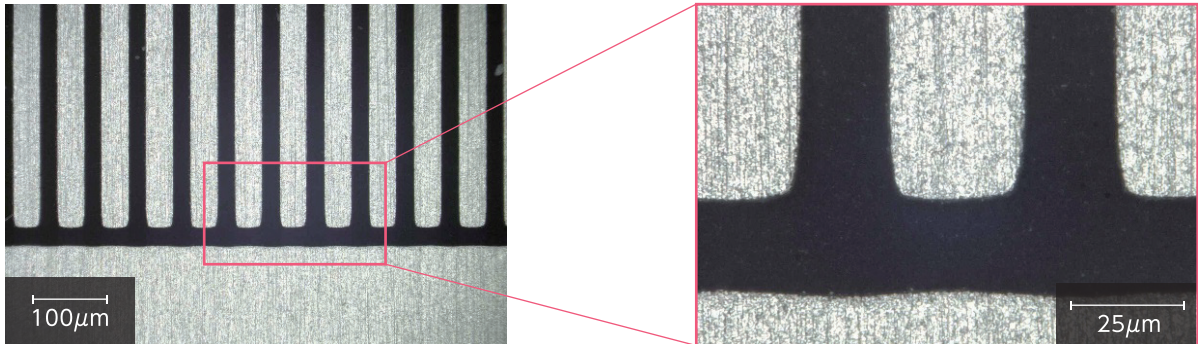
下地銅の腐食が少ない

Can reduce corrosion on base copper



ファインパターン性に優れる

Excellent in fine pattern ability



はんだ接合性に優れる

Excellent solder joint performance

